

Apr.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

適用規格		SD Card Specifications Ver 1.0				
定 格	使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃ (注1)	保存温度範囲	-40℃ ~ +85℃		
	電 圧	AC 125V	使用湿度範囲	相対湿度95%以下 (ただし、結露しないこと。)		
	電 流	0.5A				
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT AT		
構 造	外観・構造・仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○ ○		
	表 示	目視にて確認する。		○ ○		
電 氣 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗 IEC60512-2-2a	開放電圧20 mV、試験電流1 mA で測定する。	100mΩ以下 (初期値)。(注2)	○ -		
	耐 電 圧 IEC60512-2-4a	AC 500Vrmsの電圧を1分間印加する。	①せん絡・絶縁破壊がないこと。 ②漏洩電流1 mA以下。	○ -		
	絶 縁 抵 抗 IEC60512-2-3a	DC 500Vの電圧を印可し1分以内に測定する。	1000MΩ以上 (初期値)。	○ -		
機 械 的 性 能	カード挿入操作力	スピンドル25mm/minにて適合カードで測定する。	初期：10N以下。挿抜寿命後：12N以下。	○ -		
	カード引抜操作力		初期：10N以下。挿抜寿命後：12N以下。	○ -		
	挿抜寿命 (オフィス環境) EIA364b class1.1	毎時400~600回速度で、10,000回の挿抜を行う。	①接触抵抗：初期からの変化量40mΩ以下。 (挿抜により接触抵抗値が復帰すれば可。) ②極度の摩耗や破損等の異常がないこと。	○ -		
	振動・高周波 IEC60512-4-6d	片振幅0.75mm、周波数10~55~10Hzの振動をX、Y、Z軸3方向各2時間加える。	①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -		
	衝 撃 IEC60512-4-6c	加速度490m/s ² 、持続時間11msの正弦半波で3方向各3回の衝撃を加える。	①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -		
環 境 的 性 能	温湿度サイクル IEC60512-6-11m	1サイクル24時間で10サイクルの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量40mΩ以下。 ②絶縁抵抗：100MΩ以上。 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -		
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△						
備考	(注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 接触抵抗は導体抵抗を含む。 規定無き場合は温度15℃~35℃、気圧86~106kPa、湿度25~85%の試験環境下にて実施のこと。			承認	HT. YAMAGUCHI	20200318
				検図	HT. YAMAGUCHI	20200318
				担当	MT. ITANO	20200318
				製図	DS. HIROWATARI	20200317
注	QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-153563-92-00		
HRS	製品規格表		製品名	DM1B-DSF-PEJ (92)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL609-0003-5-92	△	1/2

性		能		
項目	試験方法	規格	QT AT	
環 境 的 性 能	熱 衝 撃 IEC60512-6-11d	温度 -55~ +85°C、変化時間 5分以内で 5サイクル (1サイクル=1h) の嵌合放置をする。	①接触抵抗: 初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -
	耐 熱 性 IEC60512-6-11i	温度 +85°Cに 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗: 初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -
	耐 寒 性 IEC60512-6-11j	温度 -25°Cに 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗: 初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -
	耐 湿 (定常状態) IEC60512-6-11c	温度+40°C、湿度 90~95%RH中に96hの嵌合放 置をする。	①接触抵抗: 初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -
	硫化水素ガス JEIDA 38	温度+40°C、湿度80%RH、H ₂ S 3ppmのガス中に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗: 初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗: 100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -
	塩 水 噴 霧 JIS C 5402 7.1	温度35±2°C、5±1%の塩水噴霧中に48時間の 嵌合放置をする。(後処理:塩の付着物を水洗 い後、室温に24時間放置)	①機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○ -
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-153563-92-00	
HRS	製品規格表	製品名	DM1B-DSF-PEJ(92)	
	ヒロセ電機株式会社	製品コード	CL609-0003-5-92 △ 2/2	